Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über **ConfTool:**
www.conftool.net/imaps-herbstkonferenz-2023

Für den Nachweis der Mitgliedschaft bei IMAPS-Deutschland tragen Sie bitte Ihre Mitgliedsnummer in das Registrierungsformular ein.

TEILNAHMEGEBÜHREN:
€ 170,- IMAPS-Mitglieder
€ 250,- Nichtmitglieder
€ 90,- Vortragende
€ 30,- Studierende

Die Bezahlung der Teilnahmegebühr erfolgt gegen Rechnung.

In der Teilnahmegebühr sind die Tagungsunterlagen, der Pausenkaffee und die Teilnahme an der Abendveranstaltung im Augustiner enthalten. Die Gebühren sind gemäß § 4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei.

Bitte melden Sie sich über unsere Internetseite an!

www.imaps.de

WEITERE VERANSTALTUNGEN:

EMPC 2023 – 24th European Microelectronics Packaging Conference, 11.-14. September 2023, Hinxton (bei Cambridge), England, https://www.empc2023.org

45th IMAPS Poland Conference, 24.-27. September 2023, Łańcut, Polen, https://imaps2023.prz.edu.pl

Begleitende Ausstellung

Stand ca. 6 m². Mögliche Ausstattung (bitte mit Anmeldung übermitteln):

- **Tisch** (ca. 120 x 80 cm) und 2 Stühle
- **Pinnwand** (ca. 120 x 120 cm)
- **230 V-Anschluss**

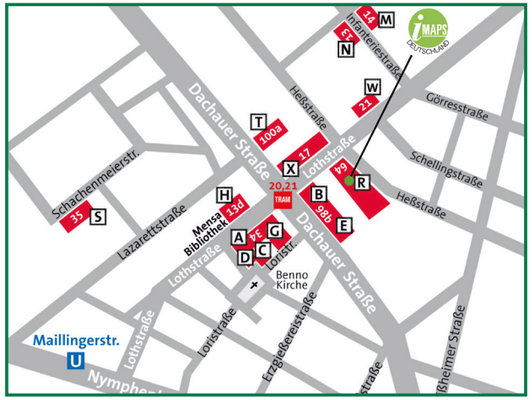
PREIS: € 790,-
Der Preis beinhaltet neben dem Stand auch die Teilnahme an der Konferenz und der Abendveranstaltung für 2 Personen.

ANMELDUNG
Sie können sich nur über unsere Internetseite als Aussteller registrieren.

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Anmeldungen zur Ausstellung werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt!

Kontakt

ANREISE MIT DER BAHN U. ÖPNV
Von München Hauptbahnhof fahren Sie mit der Tram 20 Richtung Moosach oder 21 Richtung Westfriedhof bis zur Haltestelle Lothstraße.



INFORMATIONEN + RESERVIERUNG FÜR AUSSTELLUNG:

Ernst Eggelaar, MBA
Tel.: +49 8722/9620-0
E-Mail: info@imaps.de

Deutsche IMAPS-Konferenz 2023

Herbstkonferenz
19.–20.10.2023

Hochschule München
Munich University of Applied Sciences
Lothstr. 64
D-80335 München

Foto umseitig: © Volker Mai / Fraunhofer IZM

AB 08:00 UHR EINSCHREIBUNG UND GET-TOGETHER IM FOYER

09:00 – ERÖFFNUNG UND BEGRÜßUNG
09:10 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM / IMAPS*

09:10 – SINTERN
10:25 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM / IMAPS*

09:10 Ein zweistufiger Sinterprozess für höheren Prozessdurchsatz
Benjamin Schellscheidt, Anna Steenmann, Thomas Licht, *Hochschule Düsseldorf*

09:35 Untersuchung des Einsatzes von induktiver Erwärmung beim Sintern von Halbleiterbauelementen
Knud Gripp, Ronald Eisele, *Fachhochschule Kiel*

10:00 Particle Formation and Trace Morphology of Cu Complex Inks Using Different Sintering Techniques
Nihesh Mohan, Gordon Elger, *Technische Hochschule Ingolstadt*

10:25 – VORSTELLUNG DER AUSSTELLER
10:45 Ort: Hörsaal
Chair: Dirk Schade, *XYZTEC*

10:45 – AUSSTELLUNG UND KAFFEEPAUSE
11:30 Ort: Foyer

11:30 – LTCC
12:50 Ort: Hörsaal
Chair: Jens Müller, *TU Ilmenau / IMAPS*

11:30 Maskenlose, digitale Druckverfahren für LTCC-Mikroschaltungen
Martin Ihle[1], Jonas Jäger[2], Kamil Trzebiatowski[3], Steffen Ziesche[1], [1]*Fraunhofer IKTS,* [2]*Hahn Schickard,* [3]*Technische Universität Danzig*

11:50 Keramische Mehrlagenschaltungen für die Hochspannungssensorik
Peter Uhlig[1], Richard Schmidt[2], Andreas Wien[1], Stefan Körner[2], Sebastian Stark[2], [1]*IMST GmbH,* [2]*Fraunhofer IKTS*

12:10 Heat Management and Recovery System for Electronics Using Micro-thermoelectric Generators
Nesrine Jaziri, Jens Müller, *TU Ilmenau*

12:30 Screen-printed Varistors for Thick-film and LTCC Microcircuits
Peter Keil[1], Arno Görne[2], Hannes Engelhardt[2], Uwe Krieger[1], Koji Koiwai[1], Qaisar Khushi Muhammad[1], [1]*VIA electronic GmbH,* [2]*Fraunhofer IKTS*

12:50 – MITTAGSPAUSE UND AUSSTELLUNG
13:45 Ort: Foyer

13:45 – ZUVERLÄSSIGKEIT
15:00 Ort: Hörsaal
Chair: Artem Ivanov, *University of Applied Sciences Landshut / IMAPS*

13:45 Lebensdauermodellierung der Oberseiten-kontaktierungen von SiC Leistungshalbleitern
Rasched Sankari, *Robert Bosch GmbH*

14:10 Laser Stimulated Transient Thermal Analysis: A Novel Measurement Technique for Semiconductor Reliability Characterization
Hannes Schwan[1], Maximilian Schmid[2], Gordon Elger[1], [1]*Technische Hochschule Ingolstadt,* [2]*Fraunhofer IVI*

14:35 Schnelle Visualisierung vom Vibrationsverhalten elektronischer Baugruppenn
Artem Ivanov, *University of Applied Sciences Landshut*

15:00 – AUSSTELLUNG UND KAFFEEPAUSE
15:35 Ort: Foyer

15:35 – TEST UND QUALIFIKATION
16:50 Ort: Hörsaal
Chair: Stefan Härter, *Siemens AG / IMAPS*

15:35 In-situ Untersuchung des Vernetzungsvorgangs von Epoxidharzen zur Detektion von Schwankungen in Verkapselungsprozessen elektronischer Bauteile
Corinna Niegisch[1], Sabine Haag[1], Tanja Braun[2], Ole Hölck[2], Martin Schneider-Ramelow[3], [1]*Robert Bosch GmbH,* [2]*Fraunhofer IZM,* [3]*TU Berlin*

16:00 Analyse des Schertests von Aluminium Dickdrahtbonds
Simon Kuttler, *TU Berlin*

16:25 Computertomografie in der AVT
Steffen Wiljes, *Fraunhofer ISIT*

17:00 – MITGLIEDERVERSAMMLUNG
18:00 Ort: Hörsaal
Chairs: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM/IMAPS,* Ernst J. M. Eggelaar, *Microtronic M. V. GmbH/IMAPS*

Ab 19:30 GEMEINSAMES ABENDESSEN IN DEN AUGUSTINER GASTSTÄTTEN
Neuhauser Str. 27, 1. OG, Grüner Saal

Freitag 20.10.2023

09:00 – MATERIALIEN UND PROZESSE
10:40 Ort: Hörsaal
Chair: Indira Käpplinger, *CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH / IMAPS*

09:00 Fine Pitch Kontaktierung
Adrian Bangerter, *MicroContact AG*

09:25 Ultraschall Flip Chip Bonden mit Aluminium Pillars zur elektrischen Kontaktierung ohne Under Bump Metallization
Silvia Braun, Imants Cirulis, *Fraunhofer ENAS*

09:50 Wafer Level Solder Bumping – Anforderungen und praktische Ergebnisse
Daniel Lieske, *AEMtec GmbH*

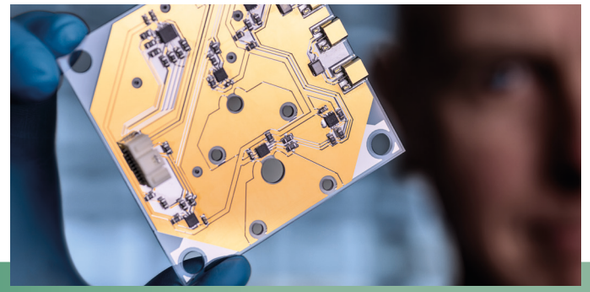
10:15 Innovation im Advanced Packaging durch 3D-Schablonendruck
Christian Ossmann, *KOENEN GmbH*

10:40 – AUSSTELLUNG UND KAFFEEPAUSE
11:30 Ort: Foyer

11:30 – ZUVERLÄSSIGKEIT UND SIMULATION
12:45 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM/IMAPS*

11:30 Simulationsbasierte Zuverlässigkeitsbewertung von elektronischen Bauteilen auf Leiterplatten
Markus Käß[1], Hendrik Schmidt[2], Moritz Hülsebrock[3], Roland Lichtinger[1], [1]*BMW AG,* [2]*TU Darmstadt,* [3]*Fraunhofer LBF*

11:55 Numerische Bewertung des thermischen Widerstands als Zuverlässigkeitsindikator für die Lötstellen-degradation von diskreten SiC-MOSFETs
Borja Kilian[1], Olaf Wittler[2], Martin Schneider-Ramelow[3], [1]*Robert Bosch GmbH,* [2]*Fraunhofer IZM,* [3]*TU Berlin*

12:20 Customized Design Libraries for Transmissions Line Structures
Jens Schneider[1], Julia Köszegi[1], Kavin Senthil Murugesan[2], Harald Pötter[1], [1]*Fraunhofer IZM,* [2]*TU Berlin*

12:45 – SCHLUSSWORT UND AUSBLICK
13:00 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM/IMAPS*